



## インライン型レーザーはんだ付け装置

### 《本製品の特長》

- ✓ SMT実装ライン直結によるDIP部品のレーザーはんだ付け溶接を実現
- ✓ 反転不要な下面からの溶接によるタクト大幅短縮
- ✓ 個々のプロセス条件が設定可能

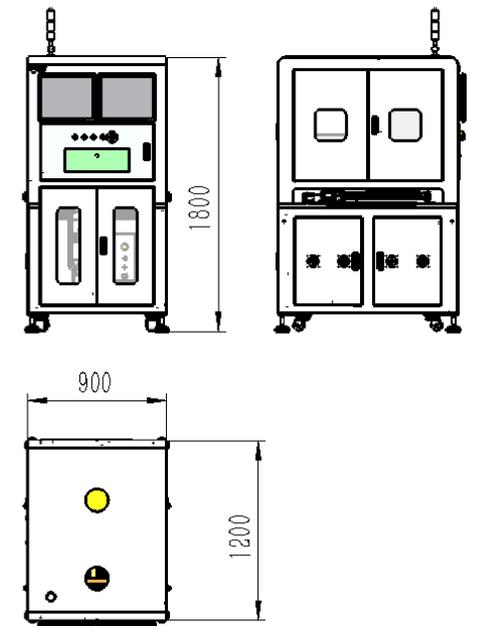
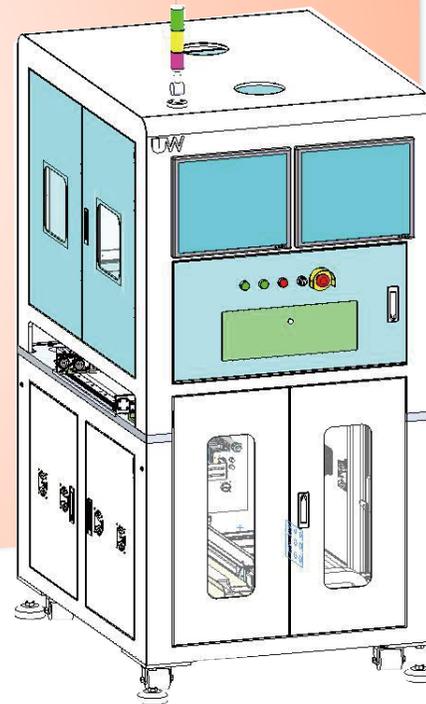
改善事例① スルーホール印刷とボイド改善

改善事例② 多様レーザー溶接条件による品質向上

## 設備標準仕様

- \* 装置寸法：W900mm×D1200mm×H1800mm（警告灯を含まず）
- \* XYZ3軸ステージを底部に配置。サーボ駆動。  
ストローク長：X軸500mm、Y軸500mm、Z軸100mm、繰り返し精度±0.03mm
- \* モニター画面×2（1.加工ポイント撮像、2.レーザ・糸はんだ送り・画像補正等各種パラメータ設定画面）
- \* 搬送高さ、900mm±20mm。
- \* 搬送可能なワークサイズは、上流から向かってW55mm-500mm、D50mm-550mm、H 5mm-15mm。  
また補正位置の設定が可能な範囲は、W200mm×D390mm。図面青色太枠参照▲▲
- \* 半導体レーザ(100W)搭載（10Wから400W機まで取り揃えております。  
ブルーレーザも搭載可）
- \* 出射角度の調整可能な出射ヘッド、糸はんだ送り先端部のニードルもフレキシブルに対応。
- \* レーザ最小スポット径：φ0.2mm、最小糸はんだ径：φ0.3mm
- \* クラス4レーザ使用のため、遮光に関する安全対策完備
- \* 多彩なオプション  
予備加熱機構、放射温度計による温度管理、ディスペンサーによる自動塗布、フラックス自動塗布

主要な機構寸法および付属機器（レーザ、糸はんだ送り機、ディスペンサー等）は、すべてご要望、ワークサイズに応じてカスタマイズが可能です。



最大レーザ出力	100W
レーザ励起光源	半導体
レーザ波長	CW
ファイバー光路	1
総消費電力	600W
照準と位置決め	赤色ガイド光指定
入力電源	AC220V±10% 50/60Hz
本体寸法	W430×D480×H770(mm)
冷却方式	空冷
ファイバーコア径	200μm
ファイバー長	5m
電気光学効率	>40%
エネルギー安定性	<±1%
光ファイバーの開口数	<0.22
加工適温温度	10~30°C
加工適温湿度	-30~75%
保管適正温度	-20~80°C
保管適正湿度	0%~90%

半導体レーザ、パラメータと  
構成一覧（参考例）



## 主な機能

- \* ワーク搬送
- \* リフローや検査工程から直結
- \* レーザによるはんだ付け  
下面からのレーザ照射、はんだ送り、  
ワークの反転不要
- \* 画像処理による位置補正  
(2ポジション認識)

## 海外での現地調達にも対応

日本・中国で設計・製作対応をいたします。  
中国国内での実証対応も承っております。

是非ともご相談ください。

お問い合わせは下記まで。レーザによる工法の適合可否を判断するための実証も承っております。

オー・エム・シー株式会社（実証環境完備）

〒569-1026大阪府高槻市緑が丘2丁目3番12号 TEL 072-688-8331番 / FAX 072-688-8332

中国現地法人：常州市欧愛西貿易有限公司 江蘇省常州市延陵西路59号投資広場1708

TEL & FAX +86(0)519-88159003

遼寧省大連市開発区金馬路160号時代広場5-1-1507

TEL +86 15061120133 / FAX +86(0)411-39262232

大連連絡事務所